This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Atsushi YAMAGUCHI et al.

Appl. No.:

09/944,186

Group:

Unknown

Filed:

September 4, 2001

Examiner: UNKNOWN

For:

NITRIDE BASED SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING DEVICE

OCT 0 1 2001

L E T T E R

mmissioner for Patents Washington, DC 20231

Date: October 1, 2001

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

JAPAN

2000-265787

September 1, 2000

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 25-0120 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

YOUNG & THOMPSON

Robert J. Patch, #17,355

745 South 23rd Street, Suite 200 Arlington, Virginia 22202 (703) 521-2297

Attachment

(Rev. 04/19/2000)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 9月 1日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-265787

出 願 人
Applicant(s):

日本電気株式会社

2001年 6月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

33409797

【提出日】

平成12年 9月 1日

【あて先】

特許庁長官

【国際特許分類】

H01S 3/18

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

山口 敦史

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

倉本 大

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

仁道 正明

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】

金田 暢之

【電話番号】

03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】

100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】

100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 089681

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9710078

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 窒化物半導体レーザ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 12 cm^{-1} 以下であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が 75~200me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項2】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A 1_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2)発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $12cm^{-1}$ 以下であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項3】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [c m⁻¹]が、

 $\alpha_i \leq 1 \ 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を $\alpha_{\mathbf{m}}$ [c m⁻¹]とする。)

であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~20 0me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項4】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、ク

ラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [cm⁻¹]が、

 $\alpha_i \le 1 \ 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を α_m [cm⁻¹]とする。)

であり、

前記活性層の微分利得 d g/d nが、

0.
$$5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2) \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2)$$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項 5 】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2)発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

【数1】

$$S \ge 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂:レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が 75~200me V であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項 6 】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2)発光層を

含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半 導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

【数2】

$$S \ge 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂:レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記活性層の微分利得 d g/d nが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項7】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0 < x < 1、 $0 \le y \le 0$. 2) 発光層を含む n 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が $2 0 0 \mu$ m以上であり、共振器端面の両面に反射率 8 0 %以上 1 0 0 %未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が1.4/n [W/A] 以上であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~200meVであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項8】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2)発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が 200 μ m以上であり、共振器端面の

両面に反射率80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半 導体レーザであって、

スロープ効率が 1. 4 / n [W/A] 以上であり、

前記活性層の微分利得 d g/d nが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項9】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I_{x}A_{y}G_{a_{1-x-y}}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

フォトルミネッセンスピーク波長分布が40me V以下であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~20 0me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項10】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \le y \le 0.2)発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

フォトルミネッセンスピーク波長分布が40meV以下であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項11】 請求項9または10に記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が12cm⁻¹以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項12】 請求項1乃至11いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $8~c~m^{-1}$ 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項13】 請求項1乃至12いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸の井戸数が3以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ

【請求項14】 請求項1乃至13いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、前記基板は、表面転位密度が10⁸個/cm²未満の窒化ガリウム系半導体基板であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項15】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0< x<1、 $0\le y\le 0$. 2)発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 12 cm^{-1} より大きく、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項16】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0< x<1、 $0\le y\le 0$. 2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 12 cm^{-1} より大きく、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1. 0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項17】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0< x<1、 $0\le y\le 0$. 2)発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [cm⁻¹]が、

 $\alpha_i > 1 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を α_m [cm⁻¹]とする。)

であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。 【請求項18】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2)発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失α_i[cm⁻¹]が、

 $\alpha_i > 1 \ 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を α_{m} [cm⁻¹]とする。)

であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1. 0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項19】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

【数3】

$$S \le 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂: レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項20】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、

クラッド層と、 $I_{x}Al_{y}Ga_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

【数4】

$$S \le 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂: レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1$. $0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項21】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $\operatorname{In}_{\mathbf{x}}\operatorname{Al}_{\mathbf{y}}\operatorname{Ga}_{1-\mathbf{x}-\mathbf{y}}\operatorname{N}$ ($0<\mathbf{x}<1$ 、 $0\leq\mathbf{y}\leq0$. 2) 発光層を含む \mathbf{n} 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が $\mathbf{1}$ mm以下であり、共振器端面のうち、レーザ出射方向側の共振器端面は、コーティング膜を備えずに前記活性層が露出しているか、または、反射率 $\mathbf{2}$ 0%以下のコーティング膜を備えており、レーザ出射方向と逆側の共振器端面に、反射率 $\mathbf{8}$ 0%以上 $\mathbf{1}$ 00%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が2.1/n[W/A]未満であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項22】 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、

クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0< x<1、 $0\leq y\leq 0$. 2)発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が1mm以下であり、共振器端面のうち、レーザ出射方向側の共振器端面は、コーティング膜を備えずに前記活性層が露出しているか、または、反射率20%以下のコーティング膜を備えており、レーザ出射方向と逆側の共振器端面に、反射率80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が2.1/n[W/A]未満であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1. 0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項23】 請求項15乃至22いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、フォトルミネッセンスピーク波長分布が40meV以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【請求項24】 請求項15乃至23いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、前記基板は、表面転位密度が10⁸個/cm²未満の窒化ガリウム系半導体基板であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板を用いた窒化物 半導体レーザに関する。

[0002]

【従来の技術】

窒化物半導体は青紫色レーザ素子の材料としてたいへん有望であり、中村他がJpn.J.Appl.Phys.vol.36(1997),pp.L1568-1571で報告しているように、既に室温において2mW出力で1万時間以上の連続発振寿命が報告されている。図10にそのレーザの断面構造図を示す。図10のレーザ素子においては、サファイア基板101上のGaN膜102上に、ストライプ状のSiO2膜(マスク)103を形成し

、その上にGaNを成長することによって選択成長させ、マスク上に横方向成長し た低転位密度のGaNを形成し、その低転位密度領域104の上にp電極105が形 成されるようにレーザ素子を作製している。中村他による上記の方法によって作 製されたGaN基板はELOG(Epitaxial Lateral Overgrowth GaN)基板と呼ばれてお り、 SiO_2 マスクの無い部分(窓領域)の上部では、サファイア基板上 GaN 膜の高 密度の貫通転位がそのまま引き継がれて膜が成長するために、高い($10^{12} \mathrm{m}^{-2}$ 以 上)転位密度となっているが、SiO₂マスクの上部ではマスクによって転位の伝播 がさえぎられるために、低い(10^{11} m $^{-2}$ 未満)転位密度が実現している。ただし 、 SiO_2 マスクの中心付近では両側の窓領域から横方向成長してきた GaN がぶつか るため、転位が新たに発生し高い転位密度となっている。そして、低転位領域(SiO_2 マスク上で中心から離れた部分:図でハッチングしてない領域)104の上 部にp電極105が形成されるようにレーザ素子を作製すると、活性層内の低転 位密度領域に電流が注入されるため、転位に起因した素子の劣化が起こりにくく なり、素子の寿命が長くなると考えられる。図10のレーザ素子は、Siドープn 型GaN-ELOG基板106上にSiドープn型In_{0.1}Ga_{0.9}N層107、120周期のSiドー プn型GaN層(厚さ2.5nm)とアンドープ $Al_{0.14}Ga_{0.86}$ N層(厚さ2.5nm)からなるn型クラッド層108、Siドープn型GaN(厚さ0.1mm)からなるn型光閉じ込め層1 09、Siドープn型In_{0.15}Ga_{0.85}N量子井戸層(厚さ3.5nm)とSiドープn型In_{0.02} $Ga_{0.98}$ N障壁層(厚さ10.5nm)からなる多重量子井戸活性層110、Mgドープp型 $Al_{0.2}Ga_{0.8}$ Nキャップ層(厚さ20nm)1.1.1、Mgドープp型GaN(厚さ0.1mm)から なるp型光閉じ込め層112、120周期のMgドープp型GaN層(厚さ2.5nm)とアン ドープ $^{
m Al}_{0.14}$ $^{
m Ga}_{0.86}$ $^{
m N}$ 層(厚さ2.5 $^{
m nm}$)からなる $^{
m p}$ 型クラッド層 $^{
m I}$ $^{
m I}$ $^{
m I}$ $^{
m I}$ $^{
m I}$ 型GaN(厚さ0.05mm)からなるp型コンタクト層114を順に成長した後に、ドラ イエッチングなどにより図に示すようなリッジ構造を形成し、最後にNiとAuから なるp電極105とTiとAlからなるn電極115を蒸着して作製されている。

[0003]

一方、発明者らはJpn.J.Appl.Phys.vol.36(1997),pp.L899-902あるいはNEC Research and Development vol.41(2000)No.1pp.74-85で述べているように、FIELO (Facet-Initiated Epitaxial Lateral Overgrowth)と呼ばれる方法によって基板

あるいは活性層全面にわたって転位密度を低くすることに成功している。FIELO においては、ELOGと同様にサファイア基板上のGaN膜上に、ストライプ状のSiO2 膜(マスク)を形成するが、ハイドライド気相成長によって選択成長させること によって貫通転位を曲げることができ、ELOGのように転位密度の高い領域は生じ ず、基板全面にわたって転位密度を低くできる。このようにして得た低転位密度 のn-GaN基板を用いて、窒化物半導体レーザを作製した例を図9に示す。図に示 すように、低転位密度のn-GaN基板21上にSiドープn型Al_{0.1}Ga_{0.9} N (シリコン濃度 4×10^{17} c m⁻³、厚さ1. 2μ m) からなる n 型クラッド層 22, Siドープn型GaN (シリコン濃度 4×10^{17} cm $^{-3}$ 、厚さ 0.1μ m) からなる n 型光閉じ込め層 2 3、 I n_{0.2}G a_{0.8}N (厚さ3n m) 井戸層と S iドープI $n_{0.05}$ G $a_{0.95}$ N (シリコン濃度 5×10^{18} c m $^{-3}$ 厚さ5 n m) バリ ア層からなる多重量子井戸層 2 4 (井戸数3個)、Mgドープp型A 1_{0.2}G a 0. $_8$ Nからなるキャップ層25、Mgドープp型GaN(Mg濃度2×10 17 cm-3、厚さ0. $1 \mu m$) からなる p型光閉じ込め層 26 , Mgドープ p型 $A1_{0.1}G$ $a_{0.9}N$ (Mg濃度2×10¹⁷cm⁻³、厚さ0.5 μ m) からなるp型クラッド 層27、Mgドープp型GaN (Mg濃度 2×10^{17} cm $^{-3}$ 、厚さ0. 1μ m) からなるp型コンタクト層28を順次成長させて、LD構造を形成した。レーザ 構造の形成は、200hPaの減圧MOVPE(有機金属気相エピタキシ)装置 を用いて行われた。窒素原料に用いたアンモニアの分圧は147hPaであり、 Ga、Al、In材料はTMG、TMA、TMIを用いた。成長温度は、InG aNからなる多重量子井戸活性層24では780℃であり、その他の層において はすべて1050℃で行った。ドライエッチングによりp型クラッド層27そし てp型コンタクト層28を含んだメサ型29を部分的に残した後、SiO2絶縁 膜30を形成した。また、メサ部分の頭出しを露光技術により行い、リッジ構造 を形成した。 n型基板裏にはTi/Alからなるn電極31を形成し、pコンタ クト上には、Ni/Auからなるp電極32を形成した。へき開によりレーザ共 振器端面を形成し、片面のみを TiO_2/SiO_2 で高反射コーティング(反射率 95%) したものと両面を TiO_2/SiO_2 で高反射コーティング(反射率95 %) したものの2つの素子を行った。得られた半導体レーザのしきい値電流密度

は片面コートのものが3. $0kA/cm^2$ 、両面コートのものが1. $5kA/cm^2$ であった

[0004]

上記の従来例にも示されているように、窒化物半導体青色レーザ素子では、通 常InGaN量子井戸が活性層に用いられている。しかし、結晶成長において均質なI nGaN混晶膜を作製することは容易ではなく、InGaN量子井戸活性層においては、 混晶組成揺らぎが生じていると考えられている。従来の半導体デバイスの常識か ら言えば、このような組成揺らぎはデバイス特性を悪化させる要因となり、根絶 すべきものである。しかしながら、窒化物半導体レーザにおいては、逆に組成揺 らぎのおかげで特性の良い素子が実現しているという指摘がある。例えば、秩父 他はAppl.Phys.Lett.,vol.71p.2346(1997)の中で、InGaN量子井戸のカソードル ミネッセンス(CL)像の観察結果からIn組成揺らぎやキャリアの拡散長について考 察を行い、従来の半導体材料に比べて桁違いに欠陥密度の高い窒化物において高 い発光効率が実現しているのは、In組成揺らぎのつくる電子(あるいは正孔)の ポテンシャル揺らぎがキャリアを局在化し、非輻射中心へのキャリア捕獲を抑制 しているためであると推察している。この議論が正しければ、欠陥密度を低減し なくても組成揺らぎを大きくすることで発光効率が向上し、デバイス特性が向上 することが期待される。しかしながら、レーザ素子では光学利得がデバイス特性 に関わるため、In組成揺らぎによって引き起こされる状態密度の変化が利得特性 を大きく変え、事情は複雑である。例えば、Chow他はAppl.Phys.Lett.,vol.71p. 2608(1997)の中で組成揺らぎは利得スペクトルの幅を広げるため、揺らぎにより 利得ピーク値が下がり、しきい値電流密度が上がると理論予測している。

[0005]

一方、活性層のIn組成揺らぎを制御する技術として、特開平11-340580号公報では、フォトルミネッセンス(以下、「PL」と略記する)ピーク波長分布から測定される活性層内の組成均一性を向上させることにより、多波長発振を防止できるとされている。同公報には、従来の半導体レーザの技術水準に関し、「InGaN混晶は非常に混ざりにくいことが知られており、非混晶領域が大きく、且つ、In組成比が0.2以下と小さい領域においても、In組成比の

増加に伴い組成分離している割合が大きくなるという問題がある。この結果、In組成比が0.15程度のInGaN層において、200μm程度のマクロな領域で見たフォトルミネッセンス(PL)スペクトルの半値幅は、組成分離による結晶内不均一を反映して非常に大きく、良い結晶でも150meVである。」ことを示している。これに対して同公報記載の半導体レーザは、品質の良好なSiC基板を用い、結晶成長速度を調整することにより、PLピーク波長分布を約90meVに低減でき、多波長発振を防止できることが示されている。

[0006]

しかしながら同公報記載の技術では、PLピーク波長分布を低減した半導体レーザの開示は、PLピーク波長分布約90meVのものにとどまり、これ以下の揺らぎの半導体レーザについての具体的開示はない。すなわち、PLピーク波長分布をさらに低減した場合、レーザ特性にどのような影響を与えるか、ということについては明らかにされていない。

[0007.]

このように、In組成揺らぎがレーザ特性に及ぼす効果はまだ総合的に理解されたという状況に至っておらず、レーザの活性層InGaN量子井戸において組成揺らぎがどうあるべきかという基本的な疑問が解決されないままとなっている。

[0008]

ところで、青色レーザの用途として最も注目されているのは、DVDなどの光ディスクに対する書き込みや読み込みの光源としての用途である。青色レーザの光出力としては、読み込み時には3mW程度の出力が、書き込み時には30mW程度の出力が必要になると言われている。そして、書き込みを伴うDVD-RAMなどに搭載するレーザ(以下高出力仕様レーザと呼ぶ)においては、30mWという高い光出力を得るために共振器ミラー面の片面(光出射側と逆側の面)だけを高反射コーティングするのが望ましいと考えられている。また、読み込みしか行わないDVD-ROMやポータブルDVDプレーヤーなどに搭載するレーザ(以下低出力仕様レーザと呼ぶ)においては、低出力動作でのしきい値電流密度を下げるために2つの共振器ミラーをともに高反射コーティング(以下、HRコーティングと称する)するのが望ましいと考えられている。

[0009]

高出力仕様レーザでは70℃において、30mW出力で5000時間以上の素子寿命が必要と考えられている。それにもかかわらず、中村他がJSAPInternationalNo.1pp. 5-17(2000)に述べているように、これまでのところ、60℃においても、30mW出力で500時間程度の素子寿命しか実現していない。30mWでの動作電流を低減することができれば、この寿命は長くなると考えられ、今後より低しきい値の高出力レーザが必要となる。

[0010]

また、低出力仕様レーザでは、電池を電源に用いたポータブルDVDプレーヤーの用途を考えると低消費電力が要求される。そのために、まず第一に、レーザの基本的な特性であるしきい値電流密度を低減することが必要となる。しかしながら、窒化物半導体レーザにおいては、従来の他の半導体レーザのように、1kA/cm²未満のしきい値電流密度は報告されておらず、著しくしきい値電流密度が高いという状況にある。

[0011]

以上のように、青色レーザは、用途に応じて異なる仕様、構成が採用される。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこうした背景を鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、高出力仕様、低出力仕様などの半導体レーザの、それぞれの仕様に応じて、活性層の I n 組成揺らぎやバンドギャップエネルギーの揺らぎを高度に制御し、これにより、しきい値電流密度を飛躍的に低減する手法を提供するものである

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る半導体レーザは、以下の事項により特定される。

[1] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含む量子井戸 構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 12 cm^{-1} 以下であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~20 0me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[2] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A 1_y G a_{1-x-y} N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む量子井戸 構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、 量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $12cm^{-1}$ 以下であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. 5×10⁻²⁰ (m²) ≤dg/dn≤0. 7×10⁻²⁰ (m²)
であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[3] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [c m⁻¹]が、

 $\alpha_i \leq 1 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を $\alpha_{\mathbf{m}}$ [\mathbf{c} \mathbf{m}^{-1}]とする。)

であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~200meVであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[4] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A 1_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含む n 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [cm⁻¹]が、

 $\alpha_i \leq 1 2 \times n - \alpha_m$

であり、

(共振器端面のミラー損失を $\alpha_{\mathbf{m}}$ [c m⁻¹]とする。)

前記活性層の微分利得 d g/d nが、

0. 5×10^{-20} (m²) \leq d g/d n \leq 0. 7×10^{-20} (m²) であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[5] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

[0014]

【数5】

$$S \ge 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0015]

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂: レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~200meVであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[6] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$. 2) 発光層を含む n 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率 S [W/A] が、下記式

[0016]

【数6】

$$S \ge 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0017]

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂:レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[7] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が200 μ m以上であり、共振器端面の両面に反射率80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が1.4/n[W/A]以上であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~20 0me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[8] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A 1_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq$ 0.2) 発光層を含むn 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が 200μ m以上であり、共振器端面の両面に反射率 80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が1.4/n [W/A] 以上であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. $5 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)} \le d \text{ g/d n} \le 0. 7 \times 10^{-20} \text{ (m}^2\text{)}$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[9] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、

 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

フォトルミネッセンスピーク波長分布が40meV以下であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が75~200meVであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[10] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、フォトルミネッセンスピーク波長分布が40 m e V以下であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

0. 5×10^{-20} (m²) \leq d g / d n \leq 0. 7×10^{-20} (m²) であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[11] [9] または [10] に記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 12 cm^{-1} 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[12] [1] 乃至 [11] いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $8 \, \mathrm{cm}^{-1}$ 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[13] [1] 乃至[12] いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、量子井戸の井戸数が3以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[14] [1] 乃至 [13] いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、前記基板は、表面転位密度が 10^8 個/ cm^2 未満の窒化ガリウム系半導体基板であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[15] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と

、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0<x<1、0 \le y \le 0.2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $12cm^{-1}$ より大きく、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[16] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $\operatorname{In}_{\mathbf{x}}\operatorname{Al}_{\mathbf{y}}\operatorname{Ga}_{1-\mathbf{x}-\mathbf{y}}\operatorname{N}$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が12cm $^{-1}$ より大きく、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1$. $0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[17] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と 、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq$ 0.2) 発光層を含む n 個の 量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失α_i[c m⁻¹]が、

 $\alpha_i > 1 \ 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失をα_m[cm⁻¹]とする。) であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[18] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と 、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む n 個の 量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

内部損失 α_i [cm⁻¹]が、

 $\alpha_i > 1 2 \times n - \alpha_m$

(共振器端面のミラー損失を α_m [cm⁻¹]とする。)

であり、

前記活性層の微分利得 d g / d n が、

 $d g / d n \ge 1. 0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[19] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \le y \le 0.2) 発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率S [W/A] が、下記式

[0018]

【数7】

$$S < 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0019]

R₁:レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂:レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[20] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ (0< x < 1、0 $\leq y \leq 0$.2) 発光層を含む n 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、

スロープ効率 S [W/A] が、下記式

[0020]

【数8】

$$S \le 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0021]

R₁: レーザ出射方向側の共振器端面の反射率

R₂: レーザ出射方向と逆側の共振器端面の反射率

 α_m : ミラー損失

を満たし、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1$. $0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[21] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xA1_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \le y \le 0.2) 発光層を含むn個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が1mm以下であり、共振器端面のうち、レーザ出射方向側の共振器端面は、コーティング膜を備えずに前記活性層が露出しているか、または、反射率20%以下のコーティング膜を備えており、レーザ出射方向と逆側の共振器端面に、反射率80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が2.1/n[W/A]未満であり、

前記発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が40meV 以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[22] 窒化ガリウム系材料またはサファイアからなる基板上に、クラッド層と、 $In_xAl_yGa_{1-x-y}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2) 発光層を含む n 個の量子井戸からなる量子井戸構造の活性層と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、共振器長が 1 m m以下であり、共振器端面のうち、レーザ出

射方向側の共振器端面は、コーティング膜を備えずに前記活性層が露出しているか、または、反射率20%以下のコーティング膜を備えており、レーザ出射方向と逆側の共振器端面に、反射率80%以上100%未満の高反射コーティング膜を備えた窒化物半導体レーザであって、

スロープ効率が2.1/n[W/A]未満であり、

前記活性層の微分利得dg/dnが、

 $d g / d n \ge 1. 0 \times 10^{-20} (m^2)$

であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[23] [15] 乃至 [22] いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、フォトルミネッセンスピーク波長分布が40meV以下であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[24] [15] 乃至[23] いずれかに記載の窒化物半導体レーザであって、前記基板は、表面転位密度が10⁸個/cm²未満の窒化ガリウム系半導体基板であることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

[0022]

上記室化物半導体レーザのうち、[1]~[14]は低出力仕様、低消費電力 用途向けの半導体レーザである。このレーザは、たとえばDVD用途に用いる場 合、読み込み専用の携帯型装置等に好適に用いられる。一方、[15]~[24]]は高出力仕様の半導体レーザであり、たとえばDVD用途に用いる場合、書き 込み可能な装置等に好適に用いられる。

[0023]

本発明は、活性層のIn組成分布やバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎ等を所定範囲に規定するものである。活性層の組成分布やバンドギャップエネルギーの「揺らぎ」には、巨視的スケールにおける揺らぎと、微視的スケールにおける揺らぎがある。巨視的スケールにおける揺らぎとは、たとえば顕微PL(フォトルミネッセンス)測定等により測定可能な距離スケールの揺らぎである。一方、微視的スケールにおける揺らぎとは、これよりも近距離の揺らぎを意味する。従来技術における「揺らぎ」とは、上記巨視的スケールにおける揺らぎ、すなわち、PL測定により観測される揺らぎを意味するのが一般的であり、測定の原

理上、1μm程度以上の距離スケールにおけるゆらぎを意味していた。

[0024]

前述した特開平11-340580号公報に記載されているのも上記巨視的スケールにおける揺らぎであり、これを低減させることにより多波長発振の防止を図っている。しかしながら、多波長発振が起こるということは、相当程度のIn組成揺らぎが存在することを意味しており、しきい値電流を制御する等の目的のためには、巨視的揺らぎをさらに低減するとともに、微視的揺らぎについて制御することが不可欠となる。

[0025]

微視的領域における揺らぎを制御することについての検討はこれまで報告された例はなく、かかる揺らぎが素子性能に与える影響は知られていなかった。また、このような微視的揺らぎを低減する具体的手段についての知見は得られていなかった。巨視的スケールにおける揺らぎを低減するためには、上記特開平11-340580号公報に記載されているように基板の転位密度の低減や、活性層の成膜速度の調整によって、ある程度実現することも可能である。しかしながら、本発明のように微視的揺らぎを低減するには、このような手段のみでは実現困難であり、さらに高度な結晶成長の制御が必要となる。

[0026]

以上のように本発明に係る窒化物半導体レーザは、従来、着目されることのなかった微視的スケールにおける発光層組成分布やバンドギャップエネルギーの揺らぎを制御し、あるいは、微分利得を一定範囲としている。微視的スケールにおける発光層組成分布やバンドギャップエネルギーの揺らぎとは、キャリア拡散長(約1μm)よりも短距離スケールにおける揺らぎという意味である。実施例2および図15(カソードルミネッセンス像)で後述するように、本発明では、サブミクロンオーダー、具体的には500nm以下のスケールにおける微視的揺らぎを制御し、これにより発光層の局所歪みを好適範囲に制御してしきい値電流の低減を図っている。

[0027]

さらに本発明では、上記微視的揺らぎについて、量子井戸一個あたりのしきい

値モード利得やレーザ内部損失の大きさに応じて、その最適範囲を規定している。すなわち、低出力仕様のレーザに関しては、たとえばしきい値モード利得を一定値以下の領域で微視的揺らぎが所定範囲内にある半導体レーザを提案し、一方、高出力仕様のレーザに関しては、たとえばしきい値モード利得が一定値を超える領域で微視的揺らぎが所定範囲内にある半導体レーザを提案するものである。

[0028]

本発明に係る窒化物半導体レーザは、しきい値電流密度が低く、消費電力が低い。したがって光ディスク用光源等の用途に好適に用いることができる。以下、本発明による窒化物半導体レーザのしきい値電流密度が低減される理由を説明する。

[0029]

本発明者らは、まず第一にInGaN量子井戸活性層における混晶組成揺らぎがレーザ素子のしきい値電流密度に及ぼす効果を明確にするため、理論的な研究を行った。まず、In組成揺らぎによるバンドギャップの空間変化を正規分布と仮定し、その標準偏差σgを組成揺らぎの指標と考えた。そして、これに対応して、バンドオフセット比(3:7)に応じて、電子と正孔のポテンシャルが空間分布していると考えた。電子、正孔ともにパラボリックな分散関係を考え、電子についてはn=1の量子準位のバンド、正孔についてはAバンドとBバンドのn=1の量子準位のバンドを考慮し、電子、正孔の状態密度を計算した。すると、揺らぎがない場合には鋭い立ち上がりの階段関数となる量子井戸の状態密度が、揺らぎがある場合には立ち上がりが緩やかな誤差関数になることが示される。このように、定量化された電子および正孔の状態密度を用いると、様々な組成揺らぎをもつ量子井戸について光学利得特性を計算することができる。

[0030]

本発明者らは、電流注入時にキャリア (電子および正孔)のフェルミエネルギーが空間的に一様であると仮定して、光学利得の計算を行った。この仮定は組成揺らぎの空間的なスケールを意識して行ったものである。すなわち、電流注入時にフェルミエネルギーが空間的に一様であるという仮定は、キャリアの拡散長に比べて組成揺らぎの空間的スケールが小さいことを意味する。キャリアの拡散長

が1mm程度であるとすれば、組成揺らぎはサブミクロン以下のスケールでなければならない。実際に、秩父他がAppl.Phys.Lett.,vol.71p.2346(1997)で報告しているように、InGaN量子井戸のCL測定などで観察されるIn組成揺らぎのスケールは数十~数百nm程度であり、上記の仮定が妥当なものであると考えている。

[0031]

図1には揺らぎが小さい場合(σ_g =3meV)、図2には揺らぎが大きい場合(σ_g =7 5meV)のInGaN量子井戸について、室温(300K)での光学利得スペクトルのキャリア 密度依存性を計算した結果を示す。まず、 $1 \times 10^{19} cm^{-3}$ のキャリア密度に着目する と、揺らぎの小さい場合には利得はまだ生じていないが、揺らぎが大きい場合に はすでに利得が生じていることがわかる。これは、揺らぎが大きい場合に、揺ら いだポテンシャルの谷にキャリアが流れ込むことによって、狭い領域にキャリア が集中し、その領域で反転分布が実現していることに対応する。実際に図2に見 られるように、利得は平均バンドギャップエネルギー (E_{CO}) よりも低エネルギー 側の局在状態で生じている。この場合、反転分布が起こり利得が生じている領域 は空間的に狭い領域であるが、反転分布の実現していない領域で吸収損失が生じ ることはなく、この領域が光に対して透明となることが前述のモデルから理論的 に証明できる。そのために、一部の領域で生じた利得が全体で見てもそれなりの 値の利得として観測されることになる。しかしながら、このような小さな領域(状態密度)での利得はすぐに飽和するため、図2で見られるように、キャリア密 度を増加させたときの利得の増加(すなわち微分利得)は小さく、また、利得の ピークは徐々に高エネルギー側にシフトしていく。これに対し、揺らぎが小さい 場合には透明キャリア密度がある程度大きいが、状態密度の急峻な立ち上がりを 反映し利得スペクトルは狭く微分利得も大きくなる。

[0032]

図3に、様々な揺らぎ(σ_g)をもつInGaN量子井戸についての最大光学利得のキャリア密度依存性の計算結果を示す。前述のように、揺らぎの大きい系では透明キャリア密度が小さくなるという点で有利であるが、微分利得が小さいという欠点をもつ。しきい値キャリア密度という観点から揺らぎの存在が有利であるか否かは、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得に依存する。図3の計算結果

によれば、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が12cm⁻¹以下の場合には揺らぎが大きい方がしきい値キャリア密度が小さくなるが、逆に量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が12cm⁻¹を超える場合には揺らぎが小さい方が有利となっている。量子井戸一個あたりのしきい値モード利得は内部損失、共振器ミラーの反射率、量子井戸数に依存するため、レーザ素子の設計によってIn組成揺らぎの功罪が入れ替わることになる。

[0033]

以上述べたように、In組成揺らぎには、透明キャリア密度を下げるという利点と、微分利得を下げるという欠点とがあり、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得の大きさによって両者の効き方が変わり、それによって活性層に望ましい揺らぎの度合いが決まってくる。これまでに、In組成揺らぎがLD特性に及ぼす効果についてはChow他がAppl.Phys.Lett.,vol.71p.2608(1997)の中で理論予測を報告しているが、彼らは揺らぎが利得スペクトルを広げる効果を取り扱っているだけで、揺らぎにより透明キャリア密度を下がる効果は無視している。したがって、彼らの結果では組成揺らぎは、レーザ特性に悪影響を及ぼす因子として扱われている。

[0034]

組成揺らぎの空間的なスケールがミクロンオーダー以上と大きい場合には、キャリアがポテンシャルの谷に集まることができず、彼らの計算のような描像になると考えられる。しかし、ミクロンスケールでは均一組成だがサブミクロンスケールで揺らぎが存在しているような活性層では、前述のような描像となり、微視的揺らぎの存在がレーザ特性向上に寄与し得る。実際、サブミクロンスケールの組成揺らぎが、前述の秩父他の報告などによって実証されており、このような描像が実現しているものと考えられる。本発明で議論するIn組成揺らぎは上記のサブミクロンスケールの揺らぎであり、ミクロン以上のスケールの揺らぎではない

[0035]

図4と図5には、しきい値電流密度の揺らぎ依存性を示す。図4は共振器の片面(光出射側と逆側の面)のみをHRコートした場合、図5は共振器の両面をHRコ

ートした場合の計算結果である。いずれにおいても、活性層は3個の量子井戸か らなり、内部損失は $15 \, \mathrm{cm}^{-1}$ としてある。ミラー損失は、片面 IR コートで $20 \, \mathrm{cm}$ $^{-1}$ 、両面HRコートで $1 \, \mathrm{cm}^{-1}$ とした。光閉じ込め係数を一井戸あたり $1 \, \mathrm{\%}$ とすると 、片面HRコートの場合は量子井戸一個あたりのしきい値モード利得14cm⁻¹程度 に相当し、両面HRコートの場合は量子井戸一個あたりのしきい値モード利得6 c m^{-1} 程度に相当する。図4では、In組成揺らぎの度合いが小さいほどしきい値電 流密度が低減しており、特に揺らぎの標準偏差を40meV以下にすることによって 顕著なしきい値低減効果が予測される。一方、図5では、In組成揺らぎを大きく した方がしきい値が下がり、揺らぎの標準偏差を75~200meVにすることによって 顕著なしきい値電流密度低減効果が現れ、しきい値電流密度は1kA/cm²以下に下 がることが予測される。上記の計算例以外の場合においても、量子井戸一個あた りのしきい値モード利得が12cm⁻¹よりも大きな値である場合には揺らぎの標 準偏差を40meV以下にすることによってしきい値電流密度が低減され、一方、量 子井戸一個あたりのしきい値モード利得が12cm⁻¹以下である場合には揺らぎ の標準偏差を75~200meVにすることによってしきい値電流密度が低減されること が示される。

[0036]

以上のように、しきい値モード利得 $(1 \, \text{井戸あたり})$ が $12 \, \text{cm}^{-1}$ 以下の場合に揺らぎを $75\sim200$ meVにするとしきい値キャリア密度が低減する。しきい値電流密度はしきい値キャリア密度に比例する量であるから、しきい値モード利得 $(1 \, \text{井戸あたり})$ が $12 \, \text{cm}^{-1}$ 以下で揺らぎ $75\sim200$ meVのときにしきい値電流密度が低減される。

[0037]

ここで、上記議論では、しきい値キャリア密度としきい値電流密度が1対1に 対応するものとして取り扱った。ところが、これらは厳密には1対1に対応する 量ではない。正しくは、しきい値電流密度は、[(しきい値キャリア密度)/(キャリアの再結合寿命)]に比例するので、キャリア再結合寿命もしきい値電流 密度に関係する。以下、この点を考慮した取り扱いを示す。

[0038]

キャリア再結合寿命は、窒化物半導体の場合、主に非輻射再結合寿命と一致すると考えられており、非輻射再結合寿命を長くすることが、キャリア寿命を長くし、しきい値電流密度の低減につながる。ところで、In組成揺らぎはキャリアが欠陥に捕まるのを抑制するので、非輻射再結合寿命を長くする効果がある。しかし、揺らぎが大きい場合でも、キャリア密度が大きくなるとキャリアがポテンシャルの谷を埋め尽くし外にまで溢れてしまうので、欠陥に捕まりやすくなり、非輻射再結合寿命は短くなる。これを具体的に計算した結果を図7に示す。図からわかるように、揺らぎが75~200meVの範囲の場合、キャリア密度が1.5×10¹⁹cm⁻³未満で、非輻射再結合寿命が顕著に長くなっている。そして、図3からわかるように、しきい値モード利得が8cm⁻¹以下であれば、揺らぎ75~200meVではしきい値キャリア密度1.5×10¹⁹cm⁻³以下が実現される。以上のことから、しきい値モード利得(1井戸あたり)12cm⁻¹以下ではしきい値キャリア密度の低減によりしきい値電流密度が低減される効果があるが、8cm⁻¹以下になると、さらにキャリア寿命が長くなる効果が加わって、より顕著にしきい値電流密度の低減が起こることがわかる。

[0039]

次に、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得とレーザ素子構造の関連について述べる。しきい値モード利得は内部損失とミラー損失の和になる。InGaN系 L Dでは量子井戸1個あたりの光閉じ込め係数が1%と見積もられるので、n個の量子井戸を活性層にもつレーザ素子では、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が $12\ c\ m^{-1}$ よりも大きな値であるということは、内部損失 α_i が、

$\alpha_i > 1 \ 2 \times n - \alpha_m$

を満たすことに対応する。逆に、 $1~2~{
m cm}^{-1}$ 以下であるということは、内部損失 α_i が、

$\alpha_i \leq 1 \times n - \alpha_m$

を満たすことに対応する。なお、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が 8 ${
m c\ m}^{-1}$ 以下であるということは、内部損失 ${
m lpha}_i$ が

$\alpha_i \le 8 \times n - \alpha_m$

さらに、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得は、内部損失を通じてスロ

ープ効率とも対応付けられる。波長400nmの半導体レーザでは、理論限界のスロープ効率が3 [W/A] となるが、実際の素子におけるスロープ効率Sは、次式のように、3 [W/A] に所定のファクタを乗じた値となる。

[0040]

【数9】

$$S = 3 \times \frac{\alpha_m}{\alpha_i + \alpha_m} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0041]

この式と前記した $\alpha_i > 12 \times n - \alpha_m$ から、下記式が導かれる。

[0042]

【数10】

$$S \le 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0043]

 R_1 、 R_2 の通常とり得る範囲を考慮し、共振器長を1 mm以下すると、上式は、S < 2. 1/n [W/A] となる。

また、前記した $\alpha_i \leq 1.2 \times n - \alpha_m$ から、下記式が導かれる。

[0044]

【数11】

$$S \ge 3 \times \frac{\alpha_m}{12 \times n} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})}$$

[0045]

 R_1 、 R_2 の通常とり得る範囲を考慮し、共振器長を200 μ m以上すると、上式は、

S≥1. 4/n [W/A] となる。

[0046]

一方、バンドギャップエネルギー揺らぎの標準偏差は、In組成揺らぎや微分利得と換算可能である。 In_xGa_{1-x} N中のIn組成微視的揺らぎの標準偏差 Δx と上述したバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差の標準偏差 σ との関係を次に説明する。Osamuraらがジャーナル・オブ・アプライドフィジックス、第46巻、3432 頁、1975 年に述べているように、 In_xGa_{1-x} Nのバンドギャップエネルギーは、

Eg(x)=3.40(1-x)+2.07x-1.0x(1-x) (単位 e V)

と表される。この式を用いると、青色レーザーダイオードの活性層に用いる I n G a N の組成の範囲(x=0. 15近傍: x=0. 1 \sim 0. 3程度)では、d E g / d x=0. 6 (e V)

となる。したがって、In組成xの空間分布の標準偏差 Δx とバンドギャップエネルギーの標準偏差 σ_g との関係は、

 $\Delta x = \sigma_{g} / 0$. 6 (eV)

となる。この関係により、前述の「バンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差の標準偏差が40meV以下であること」は「In組成微視的揺らぎの標準偏差 $\Delta \times$ が0.067以下であること」に言い換えることができ、「バンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差の標準偏差が $75\sim200meV$

であること」は「In組成微視的揺らぎの標準偏差 Δx が $0.125\sim0.33$ 3であること」と言い換えることができる。

[0047]

なお、これまで述べた事項については、 $I_{x}A_{y}G_{a_{1-x-y}}N$ (0<x<1、0 \leq y \leq 0.2)発光層を備えた素子に共通にあてはまるが、本発明における発光層は、特に、 $I_{x}A_{y}G_{a_{1-x-y}}N$ (0<x \leq 0.3、0 \leq y \leq 0.05)、あるいは、 $I_{x}G_{a_{1-x}}N$ (0<x \leq 0.3)の組成を有するものとすることが好ましい。

[0048]

また、バンドギャップエネルギー揺らぎの標準偏差は微分利得と対応付けられる。図6は揺らぎの標準偏差と微分利得の関係を前述の理論モデルに基づいて計算した結果である。図より、揺らぎが大きいほど微分利得が小さくなるのがわかる。揺らぎが大きい場合、バンド端での状態密度の立ち上がりが緩やかになるので、キャリア注入による利得飽和が起こりやすく微分利得は小さな値となる。これに対し、揺らぎが小さい場合には、量子井戸の2次元性による階段関数の状態密度が有効となり、大きな微分利得が得られる。このような機構によって、組成揺らぎの度合いと微分利得の対応関係が生じている。図6より、揺らぎの標準偏差が40meVでの微分利得が1.0×10⁻¹⁶cm²(1.0×10⁻²⁰m²)に対応していることから、前述の「揺らぎの標準偏差が40meV以下であること」は「微分利得が1.0×10⁻²⁰m²以上であること」と言い換えることもできる。また、図6より「揺らぎの標準偏差が75~200meVであること」は「微分利得が0.5×10⁻²⁰m²以上0.7×10⁻²⁰m²以下」に対応する。

[0049]

次に、本発明と従来技術との関係について説明する。ここでは従来技術の代表例として、従来技術1 (IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRO NICS, VOL.3, NO.3, JUNE 1997に記載)、従来技術2、3 (特開平11-340580号公報に記載)を挙げ、これらと本発明との関係について説明する。

[0050]

まず本発明は、基板として窒化ガリウム系材料またはサファイアを用いた上で

、活性層の組成分布やバンドギャップエネルギーの揺らぎを規定している。基板としてSiCを用いる技術もあるが、本発明においてはSiCを使用すると、しきい値電流を安定的に充分に低減することが困難となる。SiC、サファイアおよびGaN系半導体の熱膨張率の大小関係は、

サファイア>GaN系半導体>SiC

となっている。このため、SiC基板上にGaN系半導体層を成膜後、冷却すると、基板に拘束されたGaN系半導体層の水平面内に引っ張り歪みが残存する。 したがって、SiC基板を用いた半導体レーザでは、一般に、活性層に引っ張り 熱歪みが残存する。引っ張り歪みが残存した場合、組成揺らぎ、特に微視的揺ら ぎを安定的に調節することが困難となりやすい。

[0051]

これに対してサファイア基板を用いた場合は、GaN系半導体層の水平面内には圧縮熱歪みが残存することとなる。圧縮歪みに対する半導体層の強度は、引っ張り歪みに対する強度よりも高いことから、この場合は、組成揺らぎを比較的安定に調節できる。また、GaNやAlGaNからなる基板を用いた場合は、基板とその上に形成されるGaN系半導体層が等しい熱膨張率を有するため、GaN系半導体層中の残存熱歪みはほとんど発生しない。このため、組成揺らぎ、特に微視的揺らぎを安定的に調節することができる。

[0052]

以上のことから、本願発明では基板として窒化ガリウム系材料またはサファイアを用いている。

[0053]

次に揺らぎや利得の数値範囲について本発明と従来技術とを対比した結果を示す。従来技術1に記載された半導体レーザの構造を図16に示す。このレーザはサファイア基板を用いた一般的な窒化ガリウム系レーザの構造を示すものである。サファイア基板上に、GaNバッファ層を介して、A1GaNクラッド層、InGaN多重量子井戸(MQW)活性層が形成された層構造となっている。

[0054]

従来技術2、3には、SiC基板を用いた窒化ガリウム系半導体レーザが開示

されている。上記公報には、従来の半導体レーザは、共振器内の活性層のフォトルミネッセンス波長の分布が150me V程度である(これを従来技術2とする)のに対し、同公報記載の発明では90me V以下程度に低減されている(これを従来技術3とする)と記載されている。SiC基板を用いる理由については、同公報の段落161に以下のように記載されている。すなわち、「従来の短波長半導体レーザにおいては、ナイトライド系化合物半導体との格子不整合が13%程度と非常に大きなサファイアを成長基板として用いていたため、共振器内の活性層の転位密度は10¹⁰cm⁻²程度であるが、ナイトライド系化合物半導体においては、転位は非発光中心を形成しないのでデバイスの特性には影響しないと言われているので、この様な転位密度を全く問題にせずにデバイス化が進められていたが、上述の様に、転位密度と組成不均一とが相関を示し、転位密度が小さくなると組成不均一も小さくなるので、格子不整合が3%と大幅に低減されるSiC基板を用いることにより、転位密度を10⁹cm⁻²以下に、少なくとも、10⁷cm⁻²程度までは低減することができ、それによって、多波長発振の抑制された短波長半導体発光素子を実現することができる。」と記載されている。

[0055]

本発明に係る低出力仕様の半導体レーザの一例と上記従来技術との関係を図1 3 および図14に示す。図中、ハッチングを施した領域が本発明に係る窒化物半 導体レーザを含む領域である。

[0056]

図13は、横軸をIn組成の微視的揺らぎ(サブミクロンオーダーの揺らぎ)、縦軸をIn組成の巨視的揺らぎ(PL波長分布;1ミクロン以上の距離スケールの揺らぎ)としたものである。従来技術1には、微分利得が5. 8×10^{-17} c m^2 と記載されており、これは、活性層バンドギャップの巨視的揺らぎに換算すると約100meVとなる。

[0057]

従来技術では、いずれも巨視的揺らぎが大きくなっている。従来技術1には巨 視的揺らぎについての言及はないが、レーザ構造およびその作製プロセスを考慮 すると、従来技術2や3と同様の一般的な水準にあるものと考えられる。これに 対して本発明に係る半導体レーザの一例を示す図中斜線の領域は、40meV以下と従来技術に比べて低い巨視的揺らぎとなっている。

[0058]

図14は、横軸をIn組成の微視的揺らぎ(サブミクロンオーダーの揺らぎ)、縦軸を一量子井戸あたりのしきい値モード利得(cm⁻¹)としたものである。 従来技術では、いずれも一量子井戸あたりのしきい値モード利得が大きくなっている。 従来技術に係る窒化ガリウム系半導体レーザの内部損失は、通常、40cm⁻¹程度以上であり、量子井戸数が3以下であれば、ミラー損失を考慮すると一量子井戸あたりのしきい値モード利得は14cm⁻¹以上となる。これに対して本発明は、内部損失を抑えるための手段(実施例等で後述)を採用することにより、一量子井戸あたりのしきい値モード利得を12cm⁻¹以下あるいは8cm⁻¹以下に抑えている。

[0059]

次に本発明に係る高出力仕様の半導体レーザの一例と上記従来技術との関係を 図17および図18に示す。図中、ハッチングを施した領域が本発明に係る窒化 物半導体レーザを含む領域である。

[0060]

図17は、横軸をIn組成の微視的揺らぎ(サブミクロンオーダーの揺らぎ)、縦軸をIn組成の巨視的揺らぎ(PL波長分布;1ミクロン以上の距離スケールの揺らぎ)としたものである。従来技術では、巨視的揺らぎおよび微視的揺らぎともに大きくなっている。

[0061]

図18は、横軸をIn組成の微視的揺らぎ(サブミクロンオーダーの揺らぎ) 、縦軸を一量子井戸あたりのしきい値モード利得(cm⁻¹)としたものである。 従来技術では微視的揺らぎが大きくなっている。

[0062]

【発明の実施の形態】

本発明における発光層のバンドギャップエネルギーや I n 組成の微視的揺らぎに関し、その測定方法について説明する。前記したように、従来、In組成揺らぎ

を測定する方法として顕微PL測定が利用されてきたが、これではサブミクロン オーダーの微視的揺らぎを観測することは困難である。そこで本発明者らは、サ ブミクロンオーダーの微視的揺らぎを観測できる手法を見出した。以下、詳細に 説明する。図8は、前述の図9に示す半導体レーザに対して、発光寿命の温度変 化を測定した結果である。発光寿命は次のように測定した。まず、半導体レーザ 試料にピコ秒チタンサファイアレーザの第2高調波(波長370nm、出力5m W、繰り返し周波数80MHz)の光を表面から照射して励起した。発光はレン ズで分光器に集光し、分光された光を光電子増倍管で検出し、単一光子計数法に よって時間分解測定を行った。時間分解測定はストリークカメラを用いて行うこ ともできる。温度は、液体ヘリウムを用いた温度可変クライオスタットにより、 5Kから300Kの範囲で変化させた。発光寿命の温度変化はバンドギャップエ ネルギーの微視的揺らぎの標準偏差と関係している。微視的揺らぎがある場合、 光励起された電子はIn組成微視的揺らぎによって形成されたポテンシャル微視 的揺らぎの谷に捕まるため、自由に動けなくなり、欠陥(非輻射中心)に捕まる 確率が減り、発光寿命は長い値となる。しかし、温度が高くなり、熱エネルギー によって微視的揺らぎによるポテンシャル障壁を超えることができるようになる と、電子は自由に動けるようになり非輻射中心に捕まる確率が急増し、発光寿命 も急激に短くなる。図8で100K程度から発光寿命が短くなり始めているのは 、この温度以上で熱励起の効果が効き始めているからであると説明できる。定量 的には、図8の曲線は

$$\tau_{\rm PL}^{-1} = \tau_0^{-1} + A T^{1/2} e \times p \ (-T_0 / T)$$
 (1)

という式でフィッティングすることができる。ここで、 τ_{PL} は発光寿命、Tは温度、 τ_0 、A、 T_0 はフィッティングのパラメータである。上記の式は次のように説明される。温度が低い場合には、電子は揺らぎによるポテンシャルの谷に捕まってほとんど動けないため、そこでの固有の寿命 τ_0 によって再結合する。低温では上式の第二項は効かず、第一項のみが効くので発光寿命は τ_0 で一定となる。温度が高くなると、電子の熱励起が起こるが、揺らぎによるポテンシャル障壁の大きさをk T_0 (kはボルツマン定数)とすれば、励起されるキャリアの割合は $\exp(-T_0/T)$ に比例する。そして、励起されたキャリアの一部は熱速

度で動き回っている間に欠陥(非輻射中心)に捕獲される。この捕獲の確率は、 N v s で表される。ここで、N は欠陥密度、 v は熱速度、 s は捕獲断面積を表す 。温度依存性のみに着目すると熱速度が温度の平方根に比例することより、 N v s = A T $^{1/2}$

と記述できる。したがって、温度が高くなると、上記のメカニズムによって、非輻射再結合が活発化するために、キャリアの再結合速度は、 $AT^{1/2}exp$ ($-T_0/T$)、すなわち式(1)の第二項によって増加することになる。このように、フィッティングによって求められるパラメータ T_0 はIn組成揺らぎの度合いの指標となるパラメータとなる。図8ではフィッティングにより T_0 は460 K と求められる。

[0063]

次に、パラメータT₀と実際のバンドギャップエネルギー揺らぎの関係につい て述べる。 k T $_0$ は電子が自由に動けるために必要な熱エネルギーの大きさなの で、空間的に分布する電子のポテンシャル微視的揺らぎと比例関係にあるはずで ある。量子井戸のような2次元系においてポテンシャル微視的揺らぎがある場合 、ポテンシャルの空間的な平均値以下のエネルギーの電子は局在し(すなわち自 由に動けない)、平均値以上のエネルギーをもつ電子は自由に動けることが、古 典的なパーコレーション理論から導かれる。したがって、 k Τοはポテンシャル の谷底から平均ポテンシャルまでのエネルギーと考えられる。ポテンシャルの空 間分布が正規分布であるとし、その標準偏差を σ_e とすると、ポテンシャルの谷 は平均値から $2\sigma_e$ 程度低エネルギー側にあるので、 σ_e = 0. $5kT_0$ となるこ とが導かれる。InGaNのバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏 差(標準偏差: σ_g)は、伝導帯(電子)のポテンシャル微視的揺らぎと価電子 帯(正孔)のポテンシャル微視的揺らぎを加えたものになるので、「アプライド ・フィジックス・レターズ (APPLIED PHYSISCS LETTERS)、第68巻、2541 頁、1996年」においてMartinらが述べているように、InGaN系の 伝導帯と価電子帯のバンドオフセット比を3:7とすると、 $\sigma_g=3.33\sigma_e=$ 1. $67kT_0$ となる。この式を用いることによって、実験から求められる T_0 か ら、InGaNのバンドギャップエネルギーの揺らぎ(標準偏差 σ_g)を求める

ことができる。図8の場合、バンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差の標準偏差 σ_{σ} として、66 me Vという値が得られる。

[0064]

図9の半導体レーザについて1μmの微小スポット径でPL測定をした結果からは、PLピーク波長の分布が±1nmに入っており、1μmを超えるサイズのIn組成揺らぎが存在しなかった。ところが、発光寿命の温度依存性から求める方法で測定した場合には、バンドギャップエネルギーの揺らぎが観測される。このことから、図9の半導体レーザに代表される従来の半導体レーザでは、PL測定では観測にかからない微視的揺らぎ、すなわち、サブミクロンオーダーの揺らぎが存在していることがわかる。

[0065]

本発明においてIn組成やバンドギャップエネルギーの巨視的揺らぎを低減するための具体的手段として、アンモニア分圧を低くすることが有効である。たとえばアンモニア分圧を110hPa以下とし、窒化ガリウム系半導体層の成長速度を適切に選択することによりバンドギャップエネルギーの巨視的揺らぎを20meV以下とすることができる。

[0066]

このように巨視的揺らぎを低減した上でバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差を75~200me Vとするには、上記のようにアンモニア分圧を低くしてレーザ構造を形成した後、比較的高温による加熱処理を行うことが有効である。熱処理温度は、850℃以上とし、より好ましくは900℃以上とする。上限についてはたとえば1200℃以下とする。処理時間は、通常、40分以上必要となる。この熱処理は、In組成の微視的揺らぎを形成するためのものであり、電極形成時のアニールのように低温による穏やかな熱処理では目的を果たすことが困難である。

[0067]

本発明において、内部損失を減らし量子井戸一個あたりのしきい値モード利得を低減するためには、p型SCH (Self Confinement Heterostructure) 層をノンドープとし、成長温度をたとえば1100 $\mathbb C$ 以上と高くすることが有効である

。これにより内部損失を減らすことができる。一般にSCH層のp型ドープには Mgが用いられるが、Mgドープした場合、結晶性が低下するとともに不純物準 位が形成され、内部損失の低下をもたらす原因となる。この影響を排除し、さら に成長条件を適切に選択することによって内部損失を有効に低減できる。

[0068]

本発明において、フォトルミネッセンスのピーク波長分布(最大波長と最小波長の差)は、好ましくは40me V以下、より好ましくは20me V以下とする。このようにすることによってしきい値電流をより効果的に低減できる。この値が大きすぎると、しきい値電流が大きくなって消費電力が大きくなる。

[0069]

本発明において、発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差は、好ましくは75~200meV、より好ましくは80~150meVである。また、In組成xの微視的揺らぎの標準偏差は、好ましくは0.125~0.333、より好ましくは0.133~0.266とする。このようにすることによって半導体レーザのしきい値電流をより効果的に低減できる。

[0070]

本発明において、「発光層における I n 組成の微視的揺らぎ」、および、「バンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差」とは、空間分布における揺らぎ(変動)をいう。また、「微視的揺らぎ」とは、前述したように、サブミクロオーダー以下の揺らぎをいう。従来行われていた P L 測定では、通常、スポット径が 1 μ m 以上であり、測定の原理上、 1 μ m 以上の距離スケールにおけるゆらぎが観測されていた。これに対し本発明における微視的揺らぎとは、この方法では観測し得ない狭い領域内の揺らぎをいう。

[0071]

本発明において、活性層を多重量子井戸構造とする場合、上記揺らぎは、各量 子井戸層全体にわたる揺らぎを意味する。

[0072]

本発明における基板とは、レーザ等を構成する層を成長させる際に下地となる基板をいう。基板の表面転位密度とは、基板表面に存在する貫通転位の密度をい

う。

[0073]

表面転位密度が 10^8 個 $/cm^2$ 未満の窒化ガリウム系半導体基板は、以下に示す FIELO (Facet-Initiated Epitaxial Lateral Overgrowth) あるいはペンディオエピタキシ法等により窒化ガリウム系半導体層を形成後、成長に用いたサファイア等の基板を除去することにより得ることができる。以下、これらの方法について説明する。

[0074]

(FIELO)

たとえば、サファイア等の基板上に薄いGaNを形成し、その上にストライプ状の SiO_2 マスクを形成する。マスク開口部にGaNを選択横方向成長させることにより、表面転位密度の少ないGaN層が得られる。これは転位が SiO_2 マスクでブロックされるだけでなく、選択横方向成長時に基板水平方向に曲げられる為である。この方法は、「応用物理 第68巻、第7号(1999年)第774頁~第779頁」等に記載されている。

[0075]

(ペンディオエピタキシ法)

たとえば、サファイア等の基板上に低温バッファ層を形成した後、単結晶からなるGaN層を形成する。次いでマスクを用いて選択エッチングすることによりストライプ状に延びたGaNのパターンを形成する。このGaNストライプの上面または側面から結晶成長させることにより、表面転位密度の少ない下地層を形成することができる。ペンディオエピタキシ法については、たとえば「Tsvetankas.Zhelevaet.Al.; MRSInternet J. Nitride Semicond.Res. 4S1、G3.38(1999)」等に記載されている。

[0076]

また、以下のような手法を用いれば、さらに転位密度を低減した基板を得ることもできる。すなわち、サファイア基板上に直接、またはバッファ層を介して、 窒化ガリウム系材料からなる単結晶層を形成する。次いで、この単結晶層をエッチングして離間した島状の形態とする。このような形態とされた単結晶層を起点 として結晶成長させることにより、表面転位密度の少ない下地層を形成することができる。なお、上記島状の形態は、エッチングによらず、単結晶層成長条件を 適切に選択し、直接島状の形態を有する単結晶層を形成してもよい。

[0077]

本発明における基板の表面転位密度は、 10^8 個 $/cm^2$ 未満であるが、より好ましくは 10^7 個 $/cm^2$ 以下とする。基板の転位密度が高いと、In組成やバンドギャップの微視的揺らぎを低減し、あるいは微分利得を向上させても、素子寿命を向上させることは困難である。表面転位密度を 10^8 個 $/cm^2$ 未満、特に 10^7 個 $/cm^2$ 以下とした場合は、上記微視的揺らぎの低減等によりる作用との相乗作用が得られ、良好な素子特性を維持しつつ素子寿命の向上を図ることができる。なお、基板の表面転位密度は、エッチピットを測定する、あるいは、断面部をTEM観察する等、公知の方法により測定することができる。

このような低転位密度の基板は、上記島状の形態を有する単結晶層を形成し、これを起点として結晶成長を行うことにより実現することができる。

[0078]

以上、低転位密度の窒化ガリウム系半導体基板について述べたが、基板として サファイアを用い、その上に低転位密度の窒化ガリウム系半導体層を成長し、レ ーザ構造を形成した構成とすることもできる。この場合の窒化ガリウム系半導体 層の転位密度の好ましい範囲、およびその測定方法は、上記したのと同様である

[0079]

本発明の下地層は窒化ガリウム系材料からなるものであるが、ここでいう「窒化ガリウム系材料」とは、A1GaN、GaN等、構成元素として窒素およびガリウムを含む材料をいう。ここで、下地層としてGaNまたはA1GaNを用いた場合、光閉じ込め率を良好にしつつ素子寿命の改善を図ることができる。窒化ガリウム系半導体レーザでは、通常、A1GaNからなるクラッド層が用いられるが、良好な光閉じ込め率を実現するためには、クラッド層のA1組成比を高く、膜厚を厚くすることが望まれる。たとえば光ディスク用途に用いる発光波長390~430nmの半導体レーザにおいては、クラッド層の膜厚を1μm以上と

することが望ましく、A1組成比を、O.O5以上、より好ましくはO.O7以上とすることが望まれる。このような場合において、下地層としてGaNまたはA1GaNを選択することが有効となる。このようにすれば下地層とクラッド層の熱膨張係数や格子定数が近似することとなり、異種材料を下地層として用いた場合に比べ、クラッド層の残留歪みが低減するため、高温動作時における活性層の劣化を一層有効に防止できる。一方、クラッド層の膜厚やA1組成を所望の範囲とすることが可能となり、光閉じ込め率を良好にすることができる。

[0080]

以上、本発明における基板について説明したが、発光層におけるIn組成やバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差、微分利得が好適な範囲にある窒化物半導体レーザを得るためには、基板の選択だけでなく、発光層の成長条件等についても留意する必要がある。たとえば、発光層を、アンモニアガスを含む原料ガスを用いて有機金属気相成長法により形成するものとし、この際、アンモニアガスの分圧を110hPa以下、より好ましくは95hPa以下とすれば、上記微視的揺らぎ、微分利得が好適な範囲にある窒化物半導体レーザを得ることができる。

[0081]

本発明における「発光層」とは、活性層中に含まれる層であって、反転分布により利得の発生する層をいうものとする。量子井戸構造の活性層においては、量子井戸層が本発明における発光層に相当し、量子井戸構造以外の構造の活性層では、通常、活性層全体が発光層となる。

[0082]

本発明に係る低出力仕様のレーザにおいては、活性層の井戸数は3以下とすることが好ましい。しきい値電流の大きさは井戸数に依存するので、このようにすることによって消費電力を低減できる。また、量子井戸に対するキャリア注入を均一にできる。量子井戸数が4以上になると、キャリア、特にホールの注入が不均一となり、キャリア密度の不足した量子井戸において内部損失の低下が顕著となる。なお、この点に関し、Domenらは、Appl.Phys.vol.73(1998),pp.2775-2777において、井戸数が3の場合はキャリアの注入が均一となり、井戸数5の場合は

不均一となることを報告している。

[0083]

【実施例】

はじめに、実施例で作製した半導体レーザの反射率、ミラー損失、内部損失、 しきい値モード利得の測定方法について述べる。

(i) 反射率

試作したレーザ共振器の反射率 R は、半導体の面をへき開しただけの場合 R=(n-1/n+1)²と表される(例えば末松安晴伊賀健一共著光ファイバ通信入門オーム社)。但し、n は半導体の屈折率である。GaNの屈折率は波長によっても違うが典型的な窒化物半導体レーザ波長である400nmでは2.553程度であることが知られているので、反射率は19%となる。一方高反射ミラーを得るには通常誘電体多層膜を利用することが多い。これは、高い屈折率と低い屈折率の誘電体を交互に形成することで高い反射率を得ることが可能である。この時の反射率は使用する材料の屈折率と層厚と層数できまり、例えばTiO2(屈折率2.31)とSiO2(屈折率1.44)を100nmづつ交互に形成した場合の反射スペクトルを図12に示した。

[0084]

図12にあるように波長400nm付近で大きな反射率を有するスペクトルが得られた。これらのスペクトルは層数を増やすことで反射率を変えることができ、Ti0 $_2/Si0_2$ のペアを1つ形成するとおよそ50%の反射が得られ、3つにすると90%以上の反射率が得られる。従って、コーティング材料と層厚が分かれば反射率の大きさを調べることが可能である。

[0085]

形成された高反射コーティングの反射率を測定するもう一つの手段として、半導体レーザを使用することが考えられる。半導体レーザの端面の反射率R1、R2から出てくる光出力P1とP2の関係は、P1/P2=(1-R1)/(1-R2)×(R2/R1)^{0.5}である。従って、P1とP2の光出力比と片方の反射率が分かればもう一つの反射率が分かる。特に片方がアンコートの場合19%の反射率が見込まれるのでこの方法は有効である。

(ii) ミラー損失

ミラー損失はレーザの発振条件と共振器の反射率R1、R2から求められる(例えば伊賀健一著「半導体レーザ」(オーム社))。レーザの共振器長をLとするとミラー損失 α mは α m=1/2L×ln(1/R1/R2)となる。従って、共振器長とミラー反射率からミラー損失を求めることができる。

なお、通常の窒化物半導体レーザの高反射コートには TiO_2/SiO_2 などの誘電体多層膜ミラーが用いられ、反射率は80%以上である。この場合、両面HRコートの場合はミラー損失が $1~c~m^{-1}$ 程度になる。また、片面HRコートの場合、共振器長が $400~\mu$ m程度であれば、ミラー損失が $20~c~m^{-1}$ 程度になる。

(iii) 内部損失

内部損失αiは電流一出力特性から調べることができる。反射率がR1、R2である 半導体レーザにおいて、R1側から出る光出力P1は

【数12】

$$P1 = \frac{\alpha_m}{\alpha_i + \alpha_m} \times \frac{(1 - R_1)\sqrt{R_2}}{(1 - \sqrt{R_1R_2})(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2})} \times Vd \times (I - I_{th})$$

[0088]

と表すことができる。ここで、Iは電流であり、Ithはしきい値電流であり、Vdは 接合電位である。Vdは発振波長に対応する光エネルギーをほぼ同じと考えて良く 、反射率やミラー損失が分かっている素子に対しては、電流一光出力特性を調べ れば内部損失が分かる。

(iv) しきい値モード利得

レーザは利得と損失が釣り合ったところで発振をおこなう。従って、しきい値 モード利得は内部損失とミラー損失の和で求めることができる。

実施例1

図11は本実施例に係る窒化物半導体レーザーの断面構造図である。前述のF IELOにより作製した、表面転位密度が5×10⁷個/cm²の低転位n-Ga N基板21上にSiドープn型Al_{0.1}Ga_{0.9}N(シリコン濃度4×10¹⁷cm -3、厚さ1. 2 μm) からなる n型クラッド層 2 2, Siドープ n型GaN (シ リコン濃度 4×10^{17} c m⁻³、厚さ 0. 1 μ m)からなる n 型光閉じ込め層 2 3 、In_{0.2}Ga_{0.8}N (厚さ3nm) 井戸層とSiドープIn_{0.05}Ga_{0.95}N (シ リコン濃度 5×10^{18} c m $^{-3}$ 厚さ5 n m) バリア層からなる多重量子井戸層 24(井戸数3個)、Mgドープp型Al_{0.2}Ga_{0.8}Nからなるキャップ層25、ア ンドープG a N (厚さ0. 1 μm) からなる光閉じ込め層 2 6, Mgドープ p型 $Al_{0.1}Ga_{0.9}N$ (Mg濃度 2×10^{17} cm $^{-3}$ 、厚さ 0.5μ m) からなるp型 クラッド層27、Mgドープp型GaN(Mg濃度2×10 17 cm $^{-3}$ 、厚さ0. 1μm) からなる p型コンタクト層 28を順次成長させて、レーザ構造を形成し た。レーザ構造の形成は、200hPaの減圧MOVPE(有機金属気相エピタ キシ)装置を用いて行われた。窒素原料に用いたアンモニアの分圧は53hPa であり、Ga、A1、In材料はTMG、TMA、TMIを用いた。成長は、基 本的には1050℃で行った。ただし、InGaNからなる多重量子井戸活性層 24では780℃で、アンドープGaN (厚さ0. 1 μm) からなる光閉じ込め 層26では1150℃で成長を行った。成長した試料を900℃で1時間熱処理 した後、ドライエッチングにより p型クラッド層27そして p型コンタクト層2 8を含んだメサ型29を部分的に残した後、SiO₂絶縁膜30を形成した。ま た、メサ部分の頭出しを露光技術により行い、リッジ構造を形成した。n型基板 裏にはTi/Alからなるn電極3lを形成し、pコンタクト上には、Ni/A uからなるp電極32を形成した。へき開によりレーザ共振器端面を形成し、両 面を TiO_2/SiO_2 で高反射コーティング(反射率80%)を行った。共振器 長は300μmとした。

[0090]

「従来の技術」に記載した図9のレーザ素子(両面コート)と本実施例のレーザ素子の作製方法の相違点は(1)成長時のアンモニア分圧が低いこと、(2)成長後900℃で1時間熱処理していること、(3)GaN(厚さ0.1μm)

からなる光閉じ込め層 2 6 がアンドープであることと成長温度が 1 1 5 0 ℃と高いことである。(1)は活性層量子井戸の微視的揺らぎ、巨視的揺らぎをともに小さくするための手法である。(1)で揺らぎの小さい量子井戸を作製した後に、(2)の熱処理を行うと、巨視的揺らぎを小さくしたままで微視的な揺らぎだけを大きくすることができることを、発明者らは今回見出した。また、発明者らは、GaN光閉じ込め層 2 6 での光吸収がレーザ素子の内部損失の主な原因となっていることを発見し、この層での光吸収を低減するために、結晶性の向上させるために成長温度を高くし、また、不純物準位を介した吸収を減らすためにMg添加を行わないことにした。得られた半導体レーザの諸特性を表1中のNO.1に示す。しきい値電流密度は、O.8 k A / c m²と低く、良好な性能を示した。

[0091]

上記のようにして作製した半導体レーザについて、以下の測定を行った。

- ①顕微 P L 測定 (1 μ m 分解能) による巨視的組成揺らぎの測定
- ②微分利得測定(緩和振動測定)による微視的組成揺らぎの測定
- ③CL(カソードルミネッセンス)観察による微視的組成揺らぎの測定 カソードルミネッセンスによる測定では、量子井戸活性層上にキャップ層を形成 した段階で成長を止めて得た評価用サンプルを別途作製し、このサンプルに対し 電子線を照射して分光しながら特定の波長でのマッピングを行なった。加速電圧 は3kVとし、室温において測定を行った。

[0092]

1μm分解能の顕微PLで観察した結果、PL波長分布20meV以下という結果が得られたが、緩和振動測定による測定の結果、微視的揺らぎは100meVと求まった。また、CL像では400~500nmの大きさの領域が観測された(図15)。以上のことから、本実施例で作製したレーザでは、巨視的な揺らぎはほとんど存在しないがサブミクロンオーダーの微視的な揺らぎが適度に存在することが分かった。

[0093]

実施例2

本実施例に係る窒化物半導体レーザーの概略断面構造図を図11に示す。但し

、本実施例では井戸数を1としているので、量子井戸層24の構造は図示したも のと若干異なる。実施例1の半導体レーザは低出力仕様であるのに対し、本実施 例では高出力仕様となっている。以下、この半導体レーザを作製した手順につい て説明する。まず、FIELO法により作製した表面転位密度が $5 imes 1 \ 0^7$ 個/ cm²の低転位n-GaN基板21上にSiドープn型Al_{0.1}Ga_{0.9}N(シリ コン濃度 4×10^{17} c m-3、厚さ 1.2μ m)からなる n 型クラッド層22、S iドープn型GaN(シリコン濃度 4×10^{17} c m^{-3} 、厚さ $0.1 \mu m$)からな るn型光閉じ込め層23、In_{0.2}Ga_{0.8}N(厚さ3nm)井戸層とSiドープ $I_{0.05}G_{0.95}N$ (シリコン濃度 5×10^{18} c m $^{-3}$ 厚さ5n m) バリア層から なる量子井戸層 24 (井戸数 1 個)、M g ドープ p 型 A $1_{0.2}$ G $a_{0.8}$ N からなる キャップ層25、アンドープGaN (厚さ0.1 μm) からなる光閉じ込め層2 6, Mgドープp型Al_{0.1}Ga_{0.9}N (Mg濃度2×10¹⁷cm⁻³、厚さ0.5 μm) からなる p型クラッド層 27、Mgドープp型GaN (Mg濃度2×10 17 c m $^{-3}$ 、厚さ 0. 1 μ m)からなる p 型コンタクト層 2 8 を順次成長させて、 レーザ構造を形成した。レーザ構造の形成は、200hPaの減圧MOVPE (有機金属気相エピタキシ)装置を用いて行われた。窒素原料に用いたアンモニア の分圧は53hPaであり、Ga、Al、In材料はTMG、TMA、TMIを 用いた。成長は、基本的には1050℃で行った。ただし、InGaNからなる 多重量子井戸活性層24では780℃で、アンドープGaN (厚さ0.1μm) からなる光閉じ込め層26では1150℃で成長を行った。ドライエッチングに より p型クラッド層27そして p型コンタクト層28を含んだメサ型29を部分 的に残した後、SiO₂絶縁膜30を形成した。また、メサ部分の頭出しを露光 技術により行い、リッジ構造を形成した。n型基板裏にはTi/Alからなるn 電極31を形成し、pコンタクト上には、Ni/Auからなるp電極32を形成 した。へき開によりレーザ共振器端面を形成した後、光出射側と逆側の端面につ いて、 TiO_2/SiO_2 で高反射コーティング(反射率95%)を行った。なお 、光出射側端面についてはコーティング膜を形成せず、アンコートとした。共振 器長は500μmとした。

[0094]

得られた半導体レーザの諸特性を表 1 中のNO. 2 に示す。しきい値電流密度は、0. 8 k A / c m^2 と低く、良好な性能を示した。

[0095]

【表1】

	NO. 1	NO. 2
用途	低出力用途	高出力用途
量子井戸数	3	1
共振器長(μm)	300	500
量子井戸 一個あたりのしきい値モード利得	6.5	2 9
(cm ⁻¹)		
光出射側ミラー反射率 (%)	80 (HRコート)	19 (アンコート)
光出射側と逆側のミラー反射率 (%)	80 (HRコート)	95 (HRコート)
ミラー損失(c m ⁻¹)	7.4	1 7
内部損失 (cm ⁻¹)	1 2	1 2
スローブ効率(W/A)	0.57	1.7
In組成微視的揺らぎの標準偏差	0.167	0.0083
パンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏	100	5
差 (meV)		
微分利得dg/dN (×10 ° m²)	0.6	2.2
しきい値電流密度 (k A / c m²)	0.8	0.8
フォトルミネッセンス波長分布 (meV)	1 9	1 7

[0096]

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、半導体レーザのしきい値電流密度を飛躍的に低くすることができる。したがって、本発明により、光ディスク用光源として、実用可能な窒化物半導体レーザが実現できるようになり、産業上の利用価値は非常に大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

揺らぎの標準偏差が3meVの場合の利得スペクトルである。

【図2】

揺らぎの標準偏差が75meVの場合の利得スペクトルである。

【図3】

様々な揺らぎ(σ_g)をもつInGaN量子井戸についての最大光学利得のキャリア 密度依存性の計算結果を示す図である。

【図4】

しきい値電流密度の揺らぎ依存性を示す図である。

【図5】

しきい値電流密度の揺らぎ依存性を示す図である。

【図6】

揺らぎの標準偏差と微分利得の関係を計算した結果を示す図である。

【図7】

キャリア密度と非輻射再結合寿命の関係を示す図である。

【図8】

発光寿命の温度変化を測定した結果を示す図である。

【図9】

従来の半導体レーザの構造を示す図である。

【図10】

従来の半導体レーザの構造を示す図である。

【図11】

実施例に係る半導体レーザの構造を示す図である。

【図12】

 ${
m TiO_2} {
m cSiO_2}$ を交互に形成した多層膜の反射スペクトルである。

【図13】

本発明に係る半導体素子と従来の半導体素子の関係を示す図である。

【図14】

本発明に係る半導体素子と従来の半導体素子の関係を示す図である。

【図15】

カソードルミネッセンスの観察結果である。

【図16】

従来の半導体レーザの構造を示す図である。

【図17】

特2000-265787

本発明に係る半導体素子と従来の半導体素子の関係を示す図である。

【図18】

本発明に係る半導体素子と従来の半導体素子の関係を示す図である。

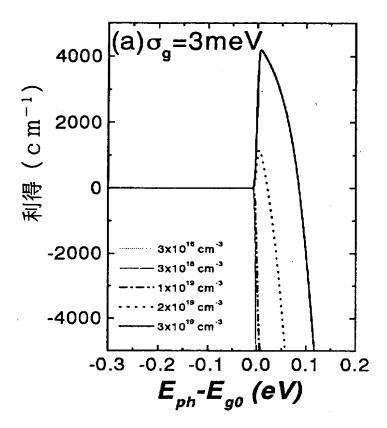
【符号の説明】

- 21 n-GaN基板
- 22 n型クラッド層
- 23 n型光閉じ込め層
- 24 量子井戸層
- 25 キャップ層
- 26 光閉じ込め層
- 27 p型クラッド層
- 28 p型コンタクト層
- 29 メサ型
- 30 SiO₂絶縁膜
- 31 n電極

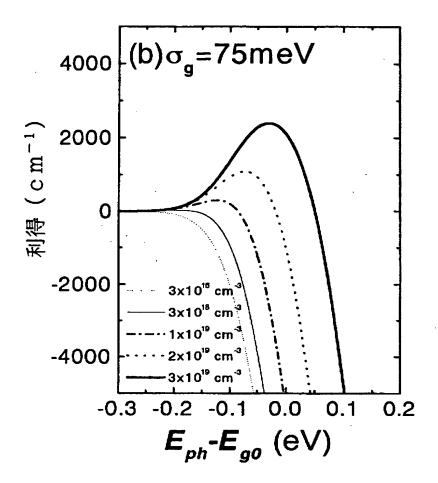
【書類名】

図面

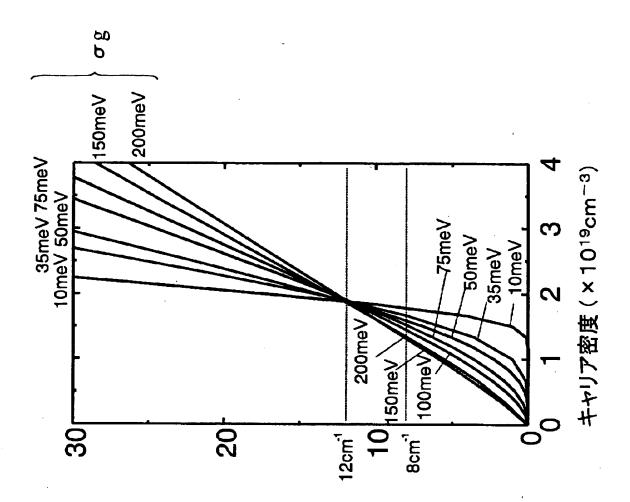
【図1】



【図2】

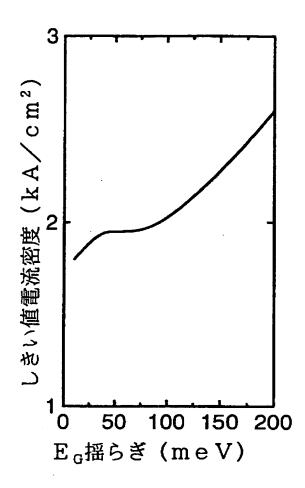




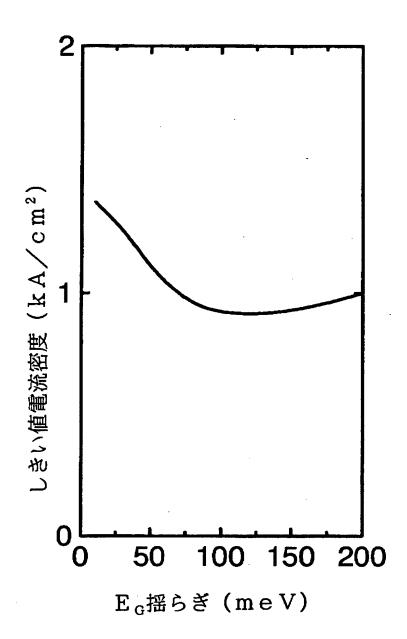


(I-ma) 制味リーチ動い考しのいすあ可共千量ー

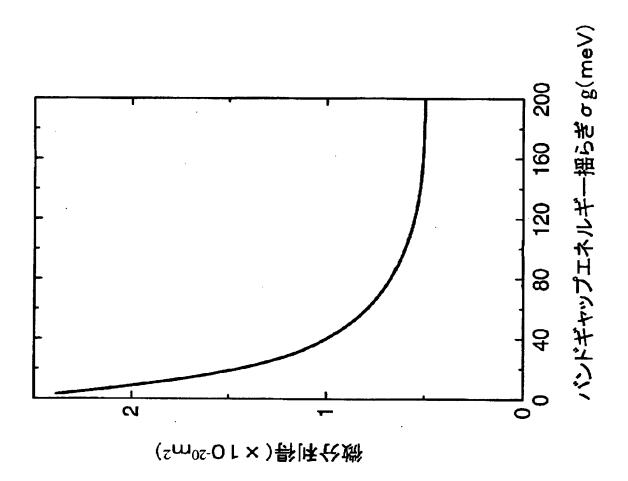
【図4】



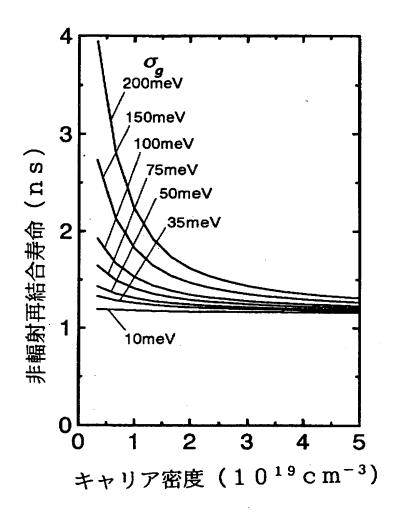
【図5】



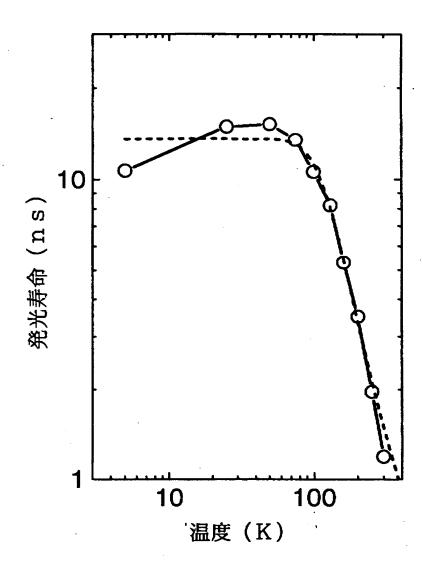
【図6】



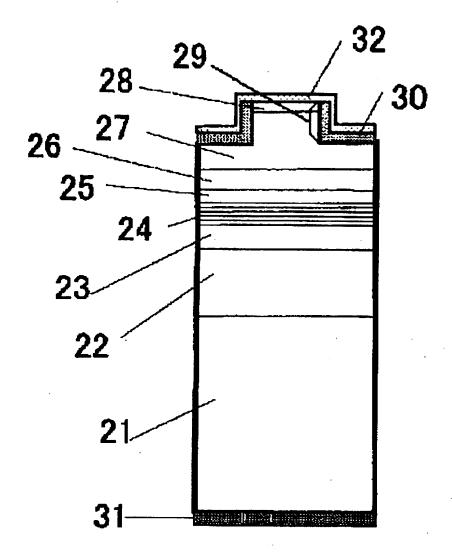
【図7】



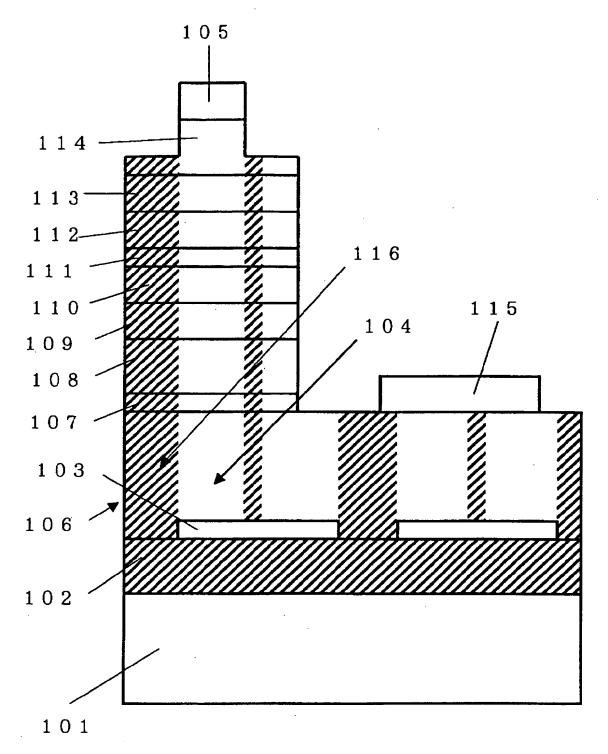
【図8】



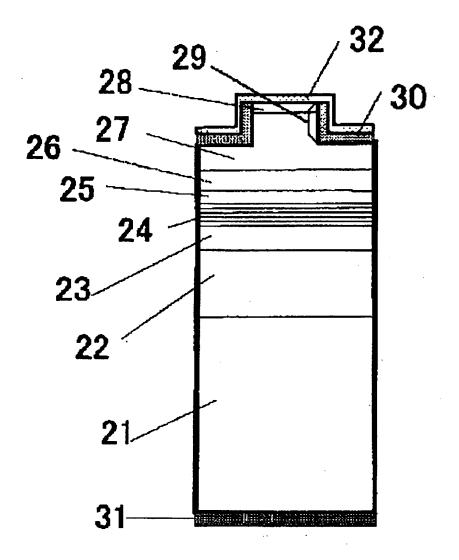
【図9】



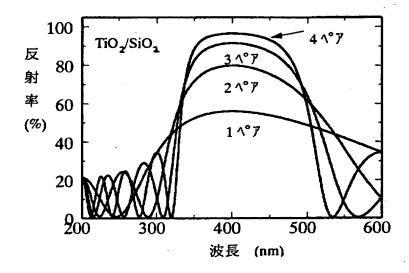
【図10】



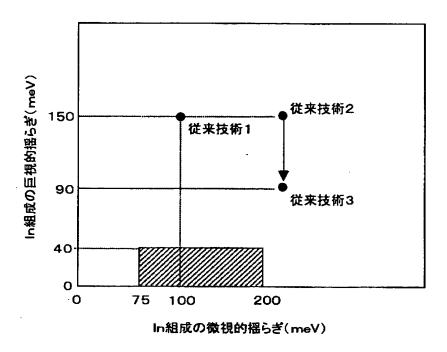
【図11】



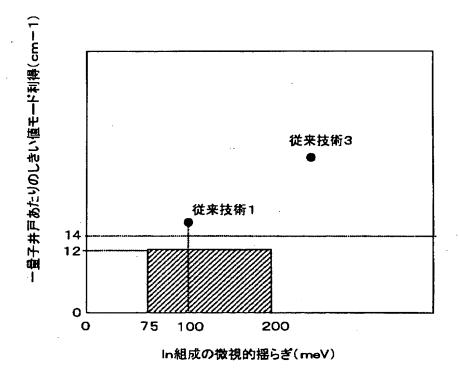
【図12】



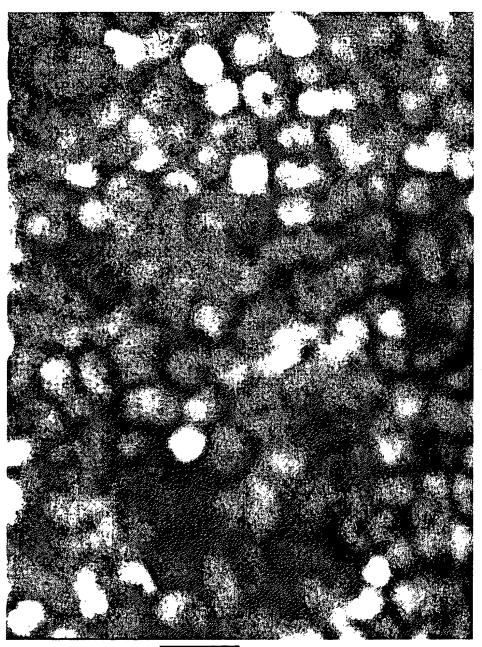
【図13】



【図14】

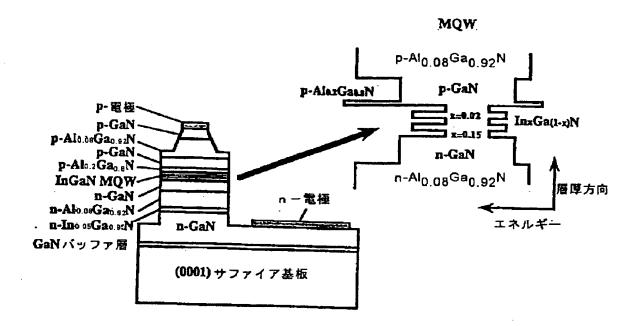


【図15】

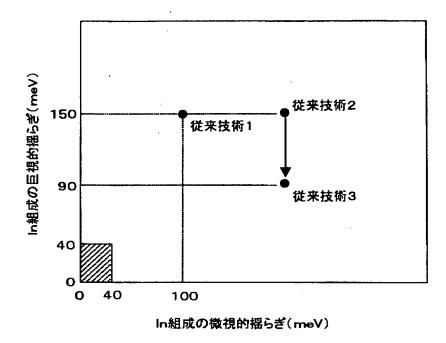


990nm

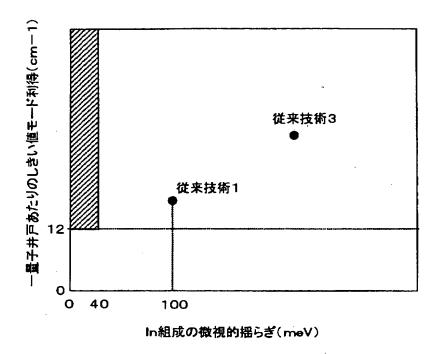
【図16】



【図17】



【図18】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】窒化ガリウム系半導体材料を用いた半導体レーザのしきい値電流密度を 低減すること。

【解決手段】低転位n-Ga N基板21上に、n型クラッド層22と、I n_x A 1_y G a_{1-x-y} N (0 < x < 1 、0 ≤ y ≤ 0 . 2)発光層を含む多重量子井戸層 2 4と、を含む窒化ガリウム系半導体層が積層した構造を有し、量子井戸一個あたりのしきい値モード利得が1 2 c m^{-1} 以下であり、発光層のバンドギャップエネルギーの微視的揺らぎの標準偏差が7 5~200 me Vであることを特徴とする窒化物半導体レーザ。

【選択図】図11

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社